

证券简称：晶合集成

证券代码：688249

合肥晶合集成电路股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2023-008

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称	德毅资产、上银基金、弥远投资、运舟资本、国君资管、浙商证券。
会议时间	2023年9月20日
会议地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	朱才伟 董事、董事会秘书、财务负责人、副总经理 黎翠綾 企划协理
投资者关系活动主要内容介绍	<p>问题 1、请介绍一下集成电路产业链？ 答复：集成电路行业呈现垂直化分工格局，上游包括集成电路材料、集成电路设备等；中游为集成电路生产，集成电路生产环节亦呈现垂直化分工格局，可以具体划分为集成电路设计、集成电路制造、集成电路封测；集成电路产业下游为各类终端应用。</p> <p>问题 2、请介绍一下公司取得的科技成果与产业深度融合的具体情况？ 答复：公司持续进行研发投入，致力追求技术突破，截至 2023 年 6 月 30 日，公司已取得了 427 项发明专利，专利分布在中国大陆、中国台湾地区、美国、日本等各个国家及地区。公司积极推动上述专利技术的实际应用，形成了特色工艺平台，为业内知名公司提供代工服务。此外，公司根据下游产品应用领域的演变趋势，正在进行多工艺平台的研发、风险量产工作，通过技术创新促进产品迭代，实现产业发展。</p> <p>问题 3、公司 40nm 产品的研发进度？ 答复：40nm 高压 OLED 平台技术开发取得重大成果，平台元件效能与良率已符合目标，具备向客户提供产</p>

	<p>品设计及流片的能力。</p> <p>问题 4、请问公司的扩产节奏？ 答复：公司目前的产能为 11 万片/月，今年计划在 55 纳米制程上再扩充 1 万片/月的产能。公司计划根据市场的复苏情况弹性规划扩产计划。</p> <p>问题 5、请问公司在车用芯片上的布局？ 答复：公司积极配合汽车产业链的需求，布局车用芯片市场。目前公司已通过显示驱动芯片及微控制器芯片的车规级 AEC-Q100 认证，未来将持续推进逻辑、电源管理以及图像传感器芯片的认证，全面进入汽车电子芯片市场。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2023 年 9 月 22 日